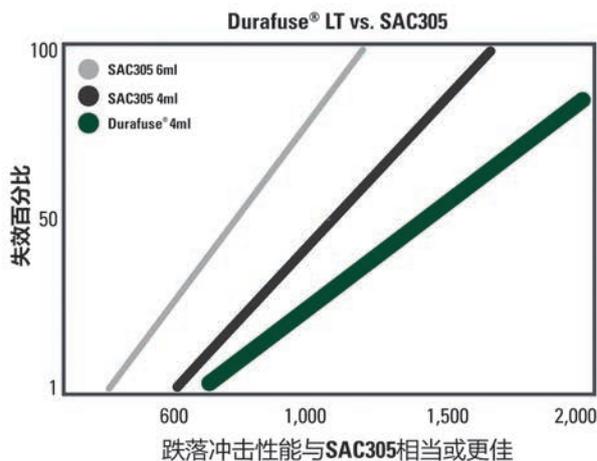
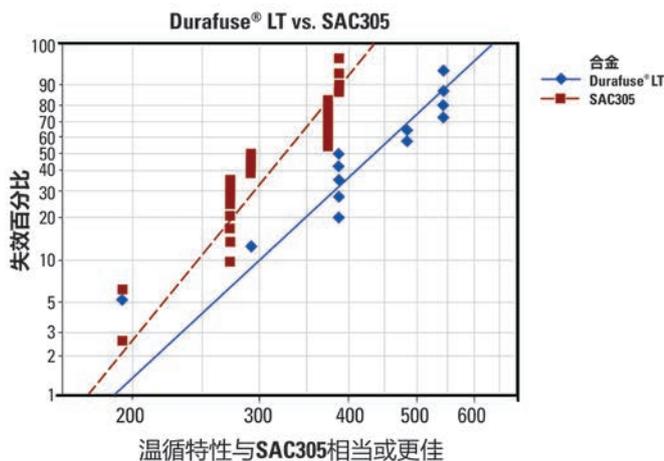


Durafuse® LT



应对工艺挑战的多功能解决方案

- 与SAC305相比,可节能10-15%,可靠性更高
- 适用于复杂的工况或设计,如阶梯焊、大温差焊接、解决大面积BGA翘曲和细间距印刷
- 市面上唯一耐摔的低温焊料
- 预防空洞,温循测试性能优异



indium.com/durafuse

联系我们的工程师: china@indium.com

有关详情: www.indiumchina.cn

From One Engineer To Another®

钢泰公司的所有焊锡膏和预成型焊片的生产工厂均通过IATF 16949: 2016认证。
钢泰公司是ISO 9001: 2015注册公司。



Durafuse® HR



高可靠性合金解决方案

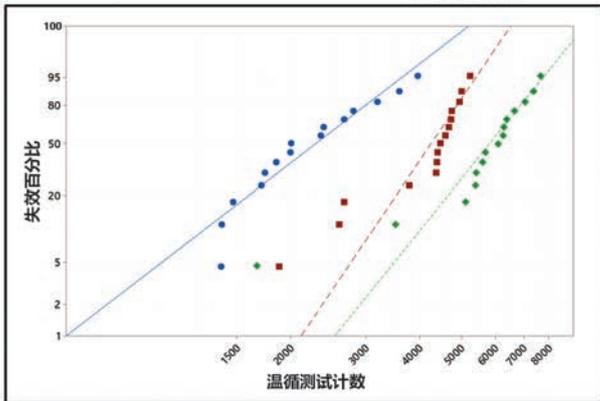
提升热循环可靠性和低空洞性能



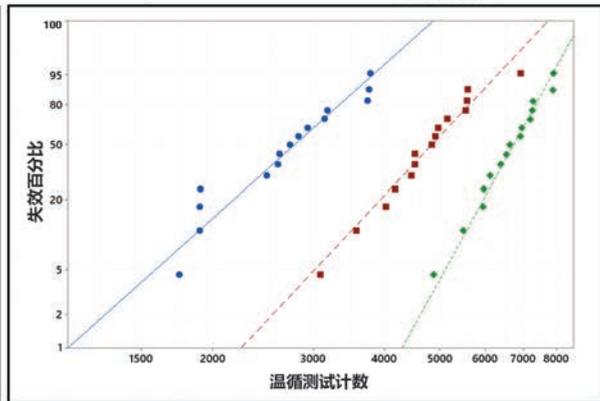
通过-40/+125 热循环条件 8,000+ 次测试

- 减少焊点开裂
- 增加剪强度
- 温循测试大于3000次循环

-40/125°C – BGA192 – ImSn 常见表面



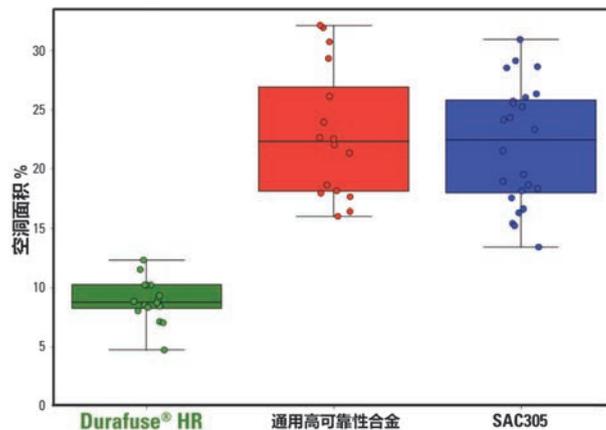
-40/125°C – QFN – ImSn 常见表面



卓越的空洞表现

- 适用于BGA, CSP, QFN等底部端子元件
- 常见表面金属处理均能实现良好润湿

QFN on ImSn 常见表面



indium.com/durafuse

联系我们的工程师: china@indium.com

有关详情: www.indiumchina.cn

From One Engineer To Another®

钢泰公司的所有焊锡膏和预成型焊片的生产工厂均通过ATF 16949: 2016认证。
钢泰公司是ISO 9001: 2015注册公司。

